

证券代码:300460

证券简称:惠伦晶体

公告编号:2021-002

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信情况及担保情况概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠伦晶体”）于2020年11月23日、2020年12月9日分别召开第三届董事会第二十次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）申请累计不超过人民币6亿元的综合授信额度，并为全资子公司的融资提供合计人民币不超过3亿元的担保额度，同时授权董事长赵积清先生或赵积清先生指定的代理人，在上述6亿元的综合授信额度以及3亿元的担保额度内，根据实际经营需要决定每一笔授信或担保的具体事宜，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件），该授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

上述具体内容详见公司于2020年11月23日和2020年12月9日披露于巨潮资讯网的《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的公告》（公告编号：2020-119）、《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-125）

二、综合授信及担保的进展情况

公司近期已与或拟与金融机构签署授信额度协议、借款合同的主要情况如下：

（一）2020年12月，公司全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司与中国银行重庆綦江支行签订了《<固定资产借款合同>补充合同》，约定借款金额由人民币5200万元增至1.06亿元，借款期限84个月，自实际提款日起算（若为分期提款，则自第一个实际提款日起算），并由公司提供连带责任担保。截至本公告日，公司全资子公司惠伦

晶体（重庆）科技有限公司累计向中国银行重庆綦江支行申请授信额度 1.06 亿元，公司提供相关连带责任担保额度 1.06 亿元。

（二）2020 年 12 月，公司与中国光大银行股份有限公司东莞分行（以下简称“光大银行东莞分行”）签订了《固定资产暨项目融资借款合同》，融资额度为人民币 6,000 万元，融资期限为 59 个月，以公司高基频小尺寸石英晶片产业化项目的设备提供抵押担保，专项用于公司高基频小尺寸石英晶片产业项目的设备采购及技术改造。交易标的基本情况如下所示：

（1）标的名称：高基频小尺寸石英晶片产业项目

（2）资产类型：固定资产

（3）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。

（4）设备原值：共计人民币 1.2 亿元。

（三）2021 年 1 月，公司拟向上海浦东发展银行深圳分行申请抵押贷款的授信额度由人民币 8,000 万元增加至人民币 12,000 万元，授信期限不超过 36 个月，用于补充流动资金，该申请已获得上海浦东发展银行深圳分行批复。抵押的资产情况如下所示：

资产名称及类型	产权证号	地址	建筑面积	账面价值（元）
房屋/厂房 A	粤房地权证莞字第 2100354107 号	东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号	14582.9	20,013,931.40
房屋/干部宿舍 C	粤房地权证莞字第 2100354108 号	东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号	1378.47	1,891,846.20
房屋/干部宿舍 B	粤房地权证莞字第 2100354109 号	东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号	1378.47	1,891,846.20
房屋/干部宿舍 A	粤房地权证莞字第 2100354110 号	东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号	1378.47	1,891,846.20
房屋/员工宿舍	粤房地权证莞字第 2100354111 号	东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号	6679.07	9,166,520.29
房屋/研发中心大楼	粤房地权证莞字第 2100874387 号	东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号	5667.14	18,754,849.32
土地	东府国用（2011）字第特 90 号	东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号	25626.3	10,830,134.26
				64,440,973.89

中国银行重庆綦江支行、光大银行东莞分行、上海浦东发展银行深圳分行均与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易目的及对公司的影响

公司根据业务发展及资金情况进行上述融资，有利于盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要，不影响公司对用于项目融资的生产设备及相关土地房产的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

四、累计综合授信及对外担保金额及逾期担保金额

上述交易完成后，公司及子公司已签署的融资协议涉及的累计融资额度为人民币44,600万元，公司为全资子公司提供的担保累计额度为1.16亿元，相关融资及担保事项在董事会审批额度内，并已由董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资关的一切事宜，无需再提交董事会审议，除此之外，公司及子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、相关授信、借款协议及银行批复文件。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021年1月12日